

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2022-001

深圳同兴达科技股份有限公司 关于签订重大合同的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、合同生效条件：合同在双方签字或盖章后生效，目前合同已生效。
- 2、合同履行对公司经营成果影响的说明：合同的履行本协议的签订暂不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。
- 3、在合同履行过程中可能因市场、政策、经济、客户需求等不可预见的或其它不可抗力等因素，从而影响最终执行情况，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日与日月光半导体（昆山）有限公司（以下简称“昆山日月光”）在深圳签订了《项目合作框架协议》，约定双方分别出资，合作“芯片先进封测（Gold Bump）全流程封装测试项目”。近日，公司、子公司昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司（以下简称“昆山同兴达”）与昆山日月光就此项目合作正式签署了《封装及测试项目合作协议》，具体投资金额以后续实际合作及项目进度情况为准。具体情况如下：

一、签约方介绍

（一）公司名称：日月光半导体（昆山）有限公司

（二）法定代表人：钟鸿儒

（三）经营范围：生产高密度印刷电路板（BGA 基板）及光电子器件等新型电子元器件。半导体（硅片及化合物半导体）集成电路元器件及分离式元器件（包含闸流体、两端子闸流体、三端子闸流体等电子产品，光敏装置除外）的封装及测试，封装型式的设计开发，测试程序的设计开发，提供晶圆针测，可靠性测试服务（国家限制类及禁止类项目除外）。生产供输送或包装集成电路产品之塑料盘。生产其它集成电路及微电子组件零件（晶体管、二极管用引线丁架，集成电路用引线丁架）。销售自产产品，并提供相关的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）设立时间：2004 年 8 月 16 日

（五）注册地址：江苏省昆山市千灯镇黄浦江南路 497 号。

（六）日月光半导体（昆山）有限公司与公司不存在关联关系，不构成关联交易，且本次交易为双方首次合作。

（七）履约能力分析：昆山日月光经营状况、财务状况和资信情况良好，具有良好的信用和较强的履约能力。

二、合同的主要内容

（一）签约主体

甲方：深圳同兴达科技股份有限公司

乙方：日月光半导体（昆山）有限公司（ASE(Kunshan) Inc）

丙方：昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司

签约方兹此同意：就共建生产线以及丙方所委托的特定集成电路提供加工 Gold Bumping、晶圆测试服务(以下称“本服务”)所涉全部事宜，及与本服务有关的一切履行，悉以本协议条款为准，并依本协议条款办理。

第一部分 共建生产线

丙方与乙方双方充分发挥各自优势，为实现互利、共赢，共同建造“芯片先进封测（Gold Bump）全流程封装测试”生产线：

1、项目名称：共建“芯片先进封测（Gold Bump）全流程封装测试”生产线

2、共建生产线所在地：江苏省昆山市千灯镇黄浦江路南路 497 号

3、双方投资金额：双方实际投资金额以经双方书面签字或盖章确认的实际投资金额为准。

4、双方权利义务：

4.1 由昆山同兴达投资 Gold Bumping（金凸块）段所需设备、晶圆测试段测试机、COF/COG 段所需专用设备至生产线所在地，产能配置 20,000 片/月。

4.2 由昆山日月光投资：

（1）Gold Bumping（金凸块）段+晶圆测试段中昆山同兴达投资项目以外的设备，包括但不限于晶圆测试段 Prober，产能配置为 20,000 片/月。

（2）项目所需且符合国家关于本项目要求和标准的全部厂房、装修、基础配套设施（包括但不限于生产附属动力设施、水电气、环保系统、化学品处理设施、消防设施、安全设施）。

（3）Gold Bumping 段和晶圆测试段所需运营团队、生产人员、知识产权/技术。

4.3 由昆山日月光提供金凸块 Bumping 及晶圆测试服务予昆山同兴达，以及本协议其他事宜。

4.4 排他性合作：公司、昆山同兴达及关联公司（合称“同兴达”）与昆山日月光及关联公司均承诺：在本合同有效期内，就本合同所约定合作事项，同兴达与昆山日月光及关联公司为彼此在中国大陆地区唯一、排他的合作方，不得与任何其他第三方进行本合同所约定的或其他构成同业竞争的合作事项。若任一方或关联公司违反此条约定，本合同签约方一致同意此属于根本违约。

第二部分 封装及测试服务

5、结算方式：按月付款。昆山同兴达内部整合特定月份应支付昆山日光月的所有账单后，根据收取的账单，按月一次支付予昆山日月光。

6、定价依据：签约方同意，在工程调试阶段，采用单片产出计费原则；进入量产损益平衡阶段后，采用“成本加成”（Cost Plus）方式计费。

7、合同有效期：本合约应自生效日开始生效，且本合约首次有效期间应为

自生效日起算五（5）年，且需受本协议提前终止及续约相关条款所规范。本协议应于协议有效期间届满后自动续约二（2）年，除非签约任一方于协议有效期间届满前至少十二（12）个月，以书面通知签约另一方，表明本协议不进行续约。

8、违约责任：昆山日月光同意，如因昆山日月光疏忽或未能履行本协议、附件或订单规定义务，所导致或发生的责任，其将赔偿昆山同兴达，使其免受伤害及负担所有责任。最终赔偿金额，双方协商决定。若昆山日月光构成根本违约，致使昆山同兴达的本合同目的无法实现，除上述赔偿外，昆山日月光同意就其在本项目中的全部投资内容，昆山同兴达享有以公允价格（经昆山同兴达认可的评估机构评估确定）购买、租赁的优先购买权和优先租赁权。

昆山同兴达：就下列情况导致或发生责任，昆山同兴达同意赔偿昆山日月光使其免受伤害及负担所有责任，最终赔偿金额，双方协商决定：昆山同兴达依据本协议所提供的任何受托加工晶圆或受托加工设备的既有瑕疵；及除规格外，昆山同兴达依据本协议规定，书面向昆山日月光特别提出的指示，且因昆山日月光无法合理避免而导致的瑕疵者。

9、争议解决方式：本协议的履行及条款解释均适用中华人民共和国法律（不包含港澳台地区法律），本协议在履行过程中所发生的任何争议，均由昆山日月光所在地人民法院裁决。

三、合同履行对公司的影响

（一）进军新领域，增强公司综合实力

作为先进封装芯片下游直接应用厂商，公司深刻了解先进封装技术在显示驱动 IC 及 CIS 芯片中的重要作用，并看好其长期发展前景。随着国内面板不断扩大产能及万物互联的趋势，显示驱动 IC 与 CIS 芯片的需求量随之增长，投资封测项目着眼于助力国内面板产业完整的显示驱动 IC 与 CIS 芯片供应链，发展卓越先进的高端封装技术，提升同兴达未来综合竞争力。

（二）向产业上游延伸，加大与上游供应商合作深度

建设先进封测产线是公司向供应链上游制造领域延伸。在目前的业务模式下，上游显示驱动 IC 及 CIS 芯片设计公司多采用 Fabless 模式，将晶圆生产和封装测试等环节分别外包。公司与全球主流 IC 设计公司长期建立良好的合作关系，建

成封测产线后可承接上游 IC 设计公司拿到晶圆后的封测订单，进一步加深与上游公司合作方式。

（三）封测项目与公司主营业务具有协同效应

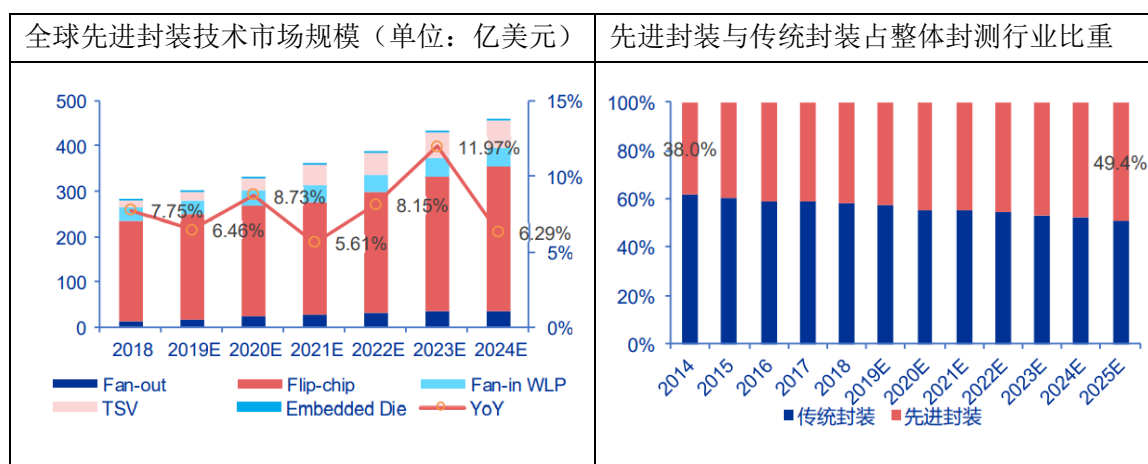
公司主营液晶显示模组和光学摄像头模组，原材料包括显示驱动 IC 和 CIS 芯片。封测项目可加强与上游芯片企业联系，一定程度保障显示及光学摄像模组业务的芯片供应，同时可降低部分采购成本，增强公司盈利能力。

以上合同的履行暂不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。

四、合同履行项目建设的可行性

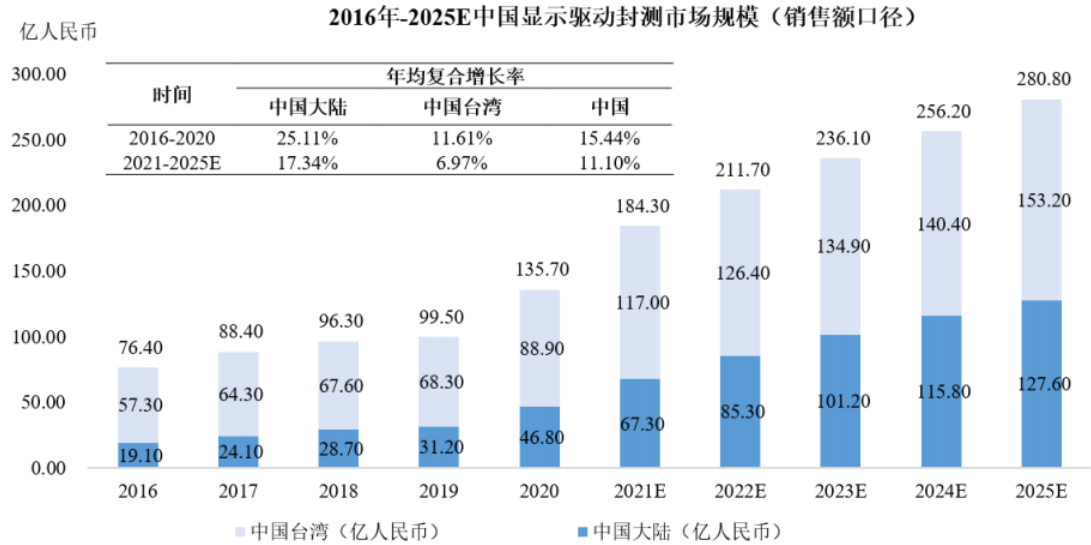
（一）先进封测领域市场空间广阔，目前为最佳进入时机

先进封装尤其是倒装芯片市场规模广阔，而凸块制造技术的重要性在于它是各类先进封装技术得以实现进一步发展演化的基础。根据 Yole 预测，2025 年先进封装的占比将提升至整体封测行业的 49.4%，其中倒装为先进封装中最大市场。2018 年先进封装市场规模约为 280 亿美元，其中倒装市场规模约 224 亿美元，占比达 80%，2018-2024 年的 CAGR 为 6%。



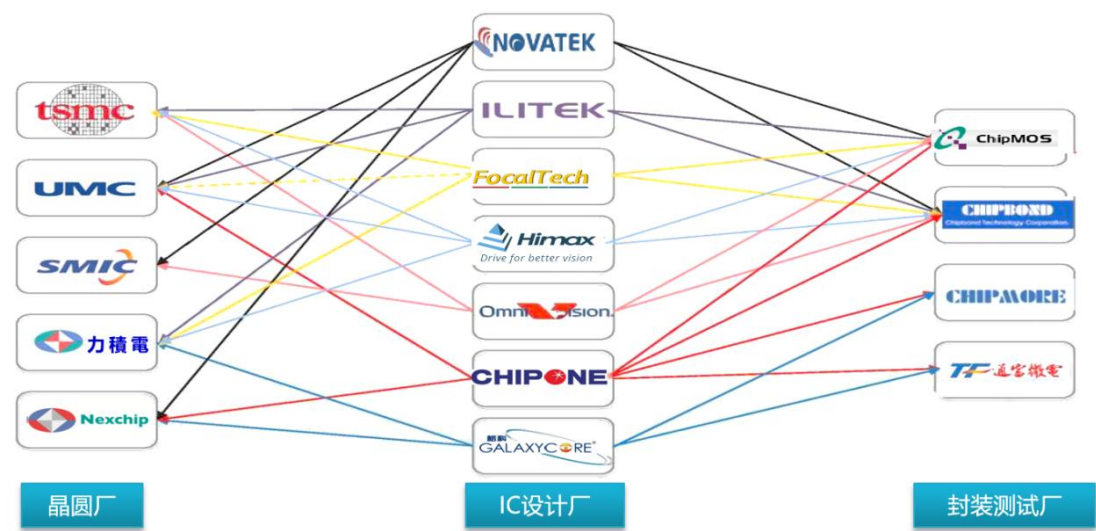
数据来源：Yole

中国大陆 Gold Bump 封测产能较少，尤其直接面对显示驱动 IC 及 CIS 芯片的 Gold Bump 封测产能更是稀缺，目前是进入此细分市场的最佳时机。仅以中国显示驱动 IC 封测市场为例，预计 2025 年市场空间达到 280.80 亿元，其中 2021 年-2025 年中国大陆市场复合增速达 17.34%。



数据来源：Frost & Sullivan

全球芯片市场主要 IC 设计、晶圆代工、封测厂商关系如下图：



（二）合作方昆山日月光提供技术支持

先进封装金凸块生产过程涉及 UBM 镀膜和光刻等高难度工序，不但需要根据产品制程特点购买配套设备，并需要由专业团队进行调试和试产，在此过程中特定设备需要持续运行和投入，如果没有专业可靠的技术团队，前期会耗费大量的时间与资源。本次项目选择昆山日月光半导体负责技术与人员事项，其具有丰富、成熟的技术和项目经验，可最大程度保证快速量产和稳定产品良率。

（三）公司显示及摄像模组业务为产品提供市场验证支持，保障订单充足

芯片封测前期需要试产验证。该项目投产后，公司可利用其显示驱动 IC 和 CIS 芯片下游应用的市场优势，协同封测厂进行制造工艺、技术参数的进一步调

试，争取在尽量短时间内完成验证并做量产。通过公司的批量采购和市场验证，逐渐形成市场口碑，有助于其他客户的开拓。

同时，公司长期与全球主流驱动 IC 设计厂商有大量采购驱动 IC 的业务往来，有较好的合作基础，满足要求的封测产线建成后有望拿到这些企业的大量订单，因此公司具备履行合同的能力。

最后本次投资资金为公司自有资金及自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、签订合同需履行的审议决策程序

本次合同的签订及履行，属于公司的日常经营活动，且不涉及关联交易。无需提交公司董事会及股东大会审议。

六、风险提示

（一）在合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化、重大疫情影响等不可控因素，公司可能将不得不面对无法按时收款的风险或合同无法如期或全面履行的风险。

（二）本次项目合作为公司首次进入新的业务领域，后续的合同执行及对公司的业绩的影响具有不确定性。

（三）本合同签订对公司当期业绩不存在重大影响情况。具体实施内容和进度公司会持续推进。在合同履行过程中如发生重大变化，公司将根据相关规定及时披露，并将在定期报告中披露合同履行情况，请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

（一）《封装及测试项目合作协议》

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日